[1] Бордусов С.В. Плазменные СВЧ технологии в производстве изделий электронной техники /Под ред. А.П. Достанко. – Мн.: Бестпринт, 2002. –452 c.

[2] Достанко, А. П. Технологические процессы и системы в микроэлектронике: плазменные, электронно-ионно-лучевые, ультразвуковые /А.П. Достанко [и др.], – Минск : Бестпринт, 2009 . – 199 с.=

[3] Достанко, А. П. Плазменные СВЧ технологии в процессах инженерии поверхности / А. П. Достанко, С. В. Бордусов,// :Журнал физики и инженерии поверхности – 2003 . – Том 1, №1.

[4] 4581100-1986 US

[5] US005882424A - 1999

[6] US2005/0090118A1

[7] US5759360-1998

[8] US 20050022933A1

[9] US491662 - 1987

[10] Пат. 10223607 JP МКИ Н 01L 21/30. Plasma treating apparatus / Mitsubishi Electric Corp.

[11] Пат. 0883159 ЕP МКИ6 H 01J 37/32. Plasma processing apparatus / Hitachi Ltd.

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[17]

[18]econbooks[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://econbooks.ru/books/part/17119  
[19]Гапонюк Н.А. Гигиеническая классификация условий труда и оценки факторов среды на продолжительность жизни человека/ Н.А. Гапонюк Москва: МГИУ, 85-86 с.

[20] Михнюк Т.Ф. Охрана труда. / Т.Ф. Михнюк Минск: ИВЦ МинФина, 181-184 с.